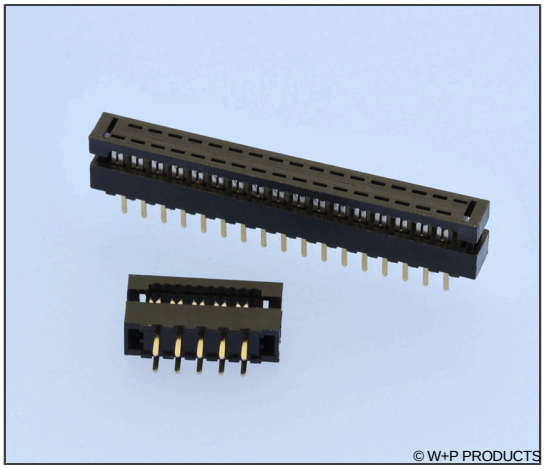
335

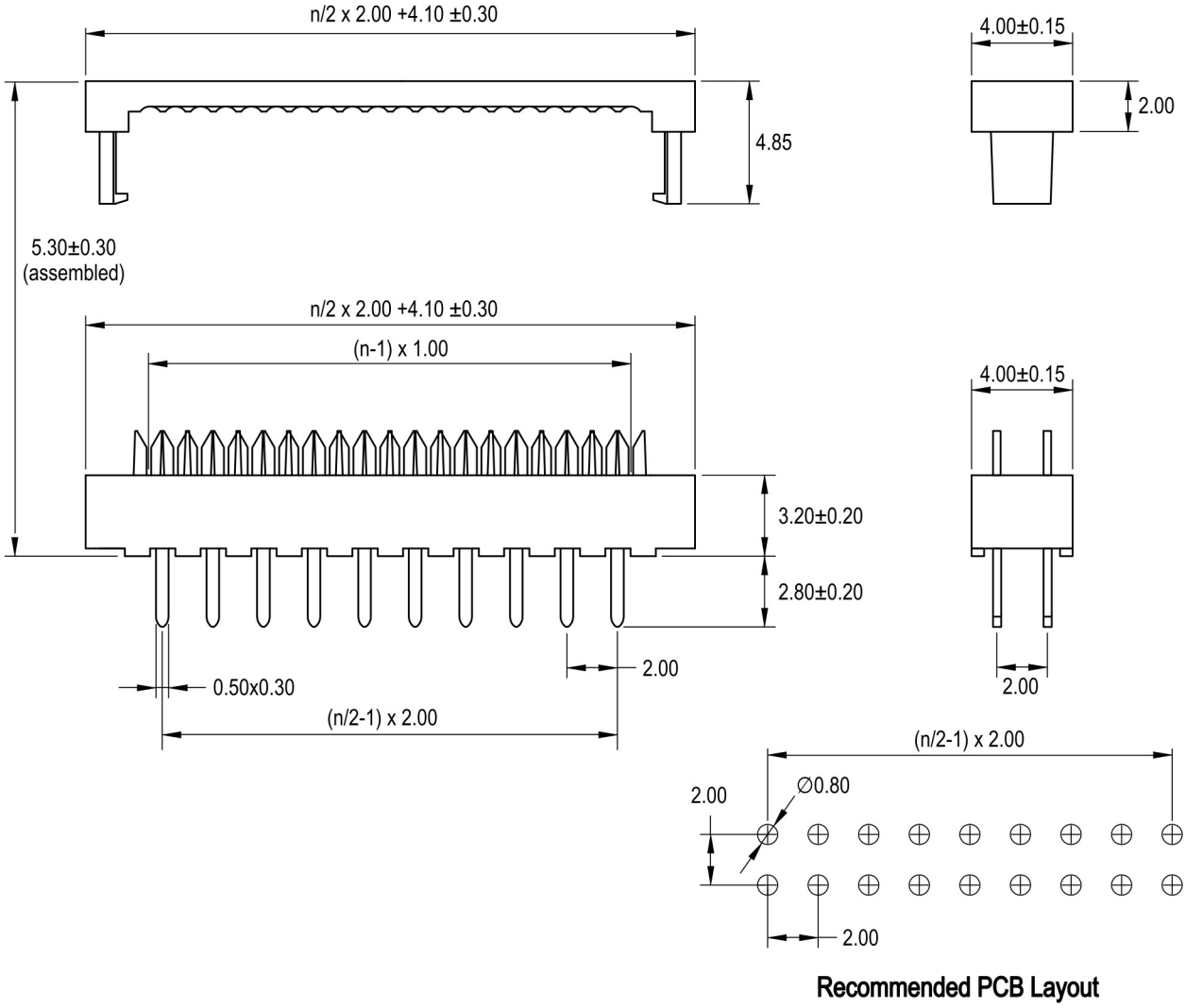
IDC Leiterplattenverbinder RM 2,00mm

IDC PCB Connectors, 2.00mm Pitch

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Kontaktoberfläche	Sel. Au / Sn über Nickel
Contact Surface	*Sel. Au / Sn over nickel*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	*500 V AC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	*-40 °C ... +105 °C*
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	*Wave soldering*





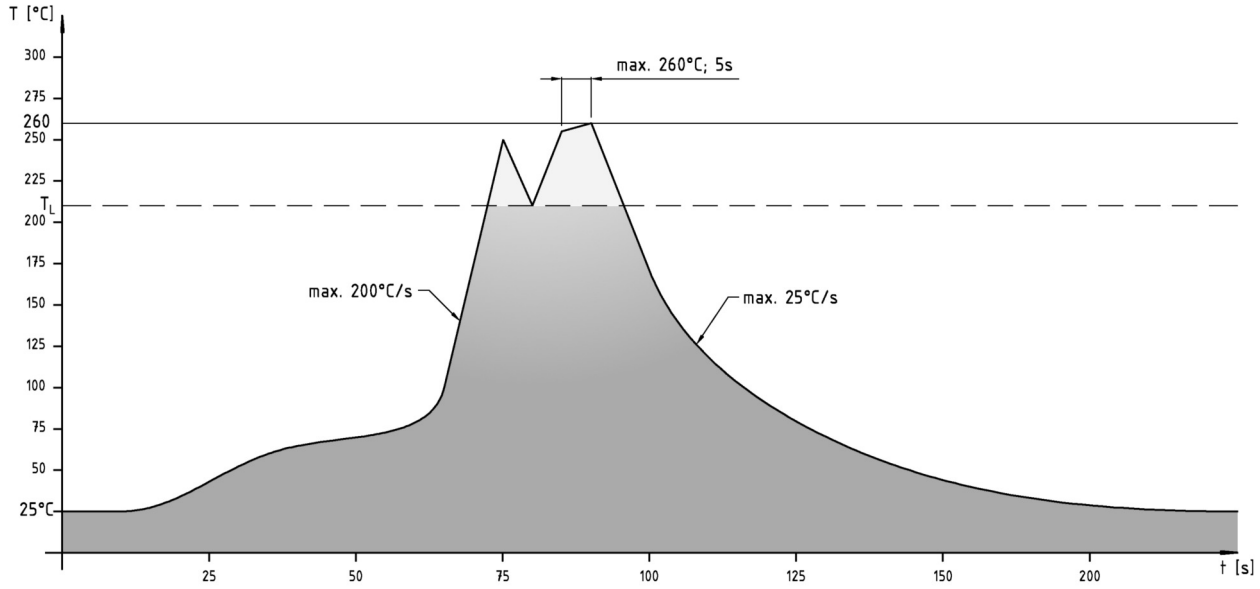
Recommended PCB Layout

Series	***Contacts****	***Plating***
335	**20**	**60**
	08-50	**60** Sel. Au / Sn

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil: